

## **ABSTRAK**

*PT Papertech Indonesia Unit II Magelang merupakan sebuah perusahaan bergerak di industri daur ulang kertas yang memproduksi berbagai produk sesuai dengan permintaan konsumen. Permasalahan yang dialami oleh PT Papertech Indonesia Unit II Magelang ini adalah produk cacat. Jenis kecacatan yang terjadi antara lain, cacat kotor, cacat robek, cacat berkerut dan cacat ukuran potongan tidak rata. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, karena perusahaan harus melakukan perbaikan kembali dan mengeluarkan biaya maupun waktu untuk memperbaiki kecacatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengendalian kualitas pada produk kertas Chip Board dan memberikan usulan perbaikan kualitasnya menggunakan metode Six Sigma dan Kaizen.*

*Pada penelitian ini dilakukan suatu pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma konsep DMAIC. Dari konsep tersebut dapat memberikan langkah dari menemukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab masalah dan menemukan solusi untuk memperbaikinya. Tools yang digunakan dalam DMAIC yaitu Critiqal To Quality (CTQ), SIPOC, Peta Kendali, Diagram Pareto, Diagram Fishbone, dan Kaizen. Kaizen digunakan untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus guna meminimalisir produk cacat yang dihasilkan.*

*Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah cacat terbanyak didominasi oleh dua jenis kecacatan yaitu jumlah cacat kotor dengan persentase 43% dan cacat robek dengan persentase 40%. Kecacatan yang terjadi disebabkan oleh proses produksi dan bahan baku. Setelah dilakukan perbaikan dengan konsep Kaizen didapatkan penurunan jumlah kecacatan dan naiknya nilai sigma yang semula 3,56 menjadi 3,89.*

**Kata Kunci :** *Cacat, Six Sigma, DMAIC, Kaizen*

## **ABSTRACT**

*PT Papertech Indonesia Unit II Magelang is a company engaged in the paper recycling industry that produces various products according to consumer demand. The problem experienced by PT Papertech Indonesia Unit II Magelang are defective products. Kind of defect had occur in their issue consist perforated, dirty defect, torn defect, wrinkle defect and size variation. This causes the company to suffer losses, because the company has to repair and cost budget and also time to repair the defect. The purpose of this research is to find out the quality control on Chip Board paper products and provide suggestions for quality improvement using Six Sigma and Kaizen methods.*

*In this research the writer uses Quality Control by using Six Sigma method of DMAIC concept. From the concept, it can give step to find the problem, to identify the causes of the problem and finding a solution to fix it. Tools used in DMAIC are Critical To Quality (CTQ), SIPOC, Control Map, Pareto Diagram, Fishbone Diagram, and Kaizen. Kaizen is used to make continuous improvements to minimize the defects produced.*

*From the results of the research that has been done, it can be seen that the highest number of defects is dominated by two types of defects are the number of dirty with a percentage of defects 43% and torn defects with a percentage of 40%. Defective products had occurred because of production process and materials. After improvement with the Kaizen concept, there was a decrease in number of defective and the increase in the sigma value which was originally 3,56 to 3,89.*

**Key Word :** *Defect, Six Sigma, DMAIC, Kaizen*